

一 产品简介

利用完善的厚薄膜平台和成熟的厚薄膜工艺，采用丝网印刷、烧结等方式进行线路制作。可以采用不同浆料和不同金属膜层制作不同电极、如金电极、银钯电极、金铂电极等，适应金锡焊，回流焊，键合等多种安装要求。同时，可集成电阻，满足客户小型化设计需求。

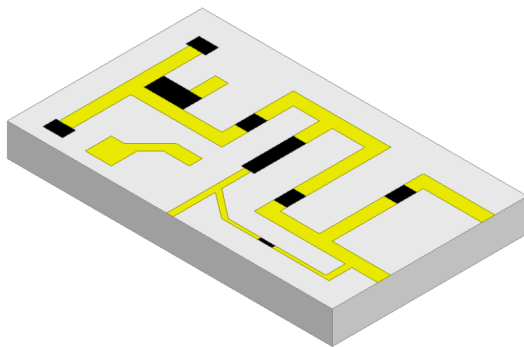
二 产品特点

- ① 散热系数好、热膨胀系数低、形状稳定、不易变形；
- ② 绝缘性好、耐压高；
- ③ 结合力强、可靠性高。

三 应用领域及功能

可广泛应用于汽车电子、航空航天、军工电子产品、通信天线，汽车点火器等领域。

四 产品外形示意图



五 基板主要参数

性能	基板类型			
	96%氧化铝陶瓷	99.6%氧化铝陶瓷	氮化铝陶瓷	其他陶瓷
介电常数@1MHz	9.6	9.8	8.8	基板特性决定
损耗角正切值@1MHz	$\leq 3 \times 10^{-4}$	$\leq 3 \times 10^{-4}$	$\leq 3 \times 10^{-4}$	基板特性决定
热导率@25°C	$\geq 24 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	$\geq 26 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	$\geq 170 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	基板特性决定
热膨胀系数 $10^{-6}/\text{°C}$	6.5 ~ 7.5@25-300°C	6.5 ~ 7.5@25-300°C	2 ~ 3@25-300°C	基板特性决定

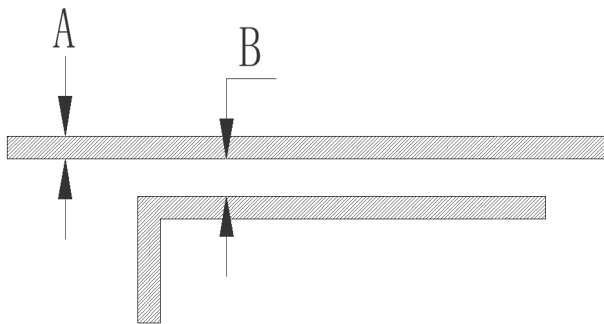
六 浆料体系

浆料	膜层属性	制作工艺
电阻浆料	电阻层	印刷+烧结
银钯浆料	导体层	印刷+烧结
金浆料	导体层	印刷+烧结
金铂浆料	导体层	印刷+烧结
端涂浆料	端面层	端涂+烧结
油墨	保护层	印刷+固化

注：用户有特殊要求时，请咨询毫米电子产品经理。

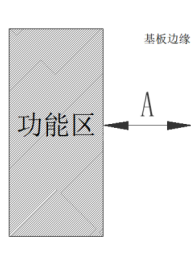
七 工艺能力

·导线宽度和间距



尺寸代码	A (mm)	B (mm)
最小尺寸	0.10	0.10
建议尺寸	≥0.20	≥0.20

·导线与基板边缘的距离



尺寸代码	A (mm)
最小尺寸	0.10
建议尺寸	≥0.20

·通孔直径及通孔金属化

尺寸代码	A(mm)
最小尺寸	0.20
建议尺寸	≥0.25

注：推荐孔径尺寸需根据基板厚度等因素决定

·陶瓷印制板加工流程：

